

AT-90

미세패턴의 선택부분 도금용 중성 활성화제

AT-90은 중성의 팔라듐계 활성화제 입니다.

중성이므로 소재 혹은 소재 금속, 인쇄 패턴, 레지스트 등에 손상 없이 활성화하여 이후 무전해 도금 공정에서 석출을 균일하게 하고 밀착성을 향상 시킵니다. 특히 알칼리성에 약한 알루미늄 기판상 도금, 하이브리드 IC의 각종 페이스트상의 도금 등, 레지스트에 손상 없이 프린트 기판상 선택 부분 도금에 탁월한 효과를 발휘합니다.

1. 특징

- ① 액성이 중성이므로 산성, 알칼리성에 약한 재질, 인쇄 패턴 레지스트가 있는 부품에 사용하는 활성화제 입니다.
- ② 미세, 독립 패턴 상의 도금으로 미도금 이나 번짐 등이 없습니다.
- ③ 도금의 밀착성이 뛰어 납니다.
- ④ 중성이므로 취급이 용이합니다.

2. 사용조건

건욕방법	사용온도	처리시간	요동	보급방법	갱신기준
AT-90 원액사용	50~70℃ (60℃)	2~10분 (5분)	2~10m/min 20~40rpm	Drag-out으로 감소된 양만큼 보급	200~400dm ² /L 재갱신 1~2주간 8hr/일X(7~14일)

상기 사용 조건은 AIN상의 W 페이스트에 Ni-B 도금 조건입니다.

3. 용도

- ① 세라믹 상 도전성 패턴에의 활성화
AIN 기판상 W, Mo-Mn 페이스트 활성화, Al₂O₃ 기판상의 W, Mo-Mn 페이스트 활성화
- ② 각종 세라믹 기판상의 동 페이스트 활성화
- ③ 프린트 기판의 선택부분의 도금을 위한 활성화
- ④ 각종 세라믹 기판상의 Ag, Ag-Pd 페이스트 활성화
- ⑤ CVD, PVD, 증착, 스퍼터 막의 활성화
- ⑥ 내산, 내알칼리성이 없는 소재의 활성화
- ⑦ 내알칼리성이 없는 레지스트 기판상의 도금을 위한 활성화

4. 사용상 주의사항

- ① 재질이나 표면상태 등에 의해 사용 방법이 다른 경우가 있기 때문에 미리 실험실 테스트에 의해 사용 조건의 확인이 필요합니다.
- ② AT-90 침적 전에 반드시 염산이나 황산에 침적하여 표면의 산화물 등을 제거하여 주십시오.
- ③ AT-90 침적 후 무전해 니켈 도금 전에도 염산이나 황산에 침적하여 가속화를 실시하는 편이 도금의 석출을 균일하게 합니다.
- ④ AT-90은 소재 금속에 팔라듐 치환도금을 한 후 밀착이 약한 팔라듐을 산세, 초음파 세정 등에 의해 완전하게 제거하는 방법입니다.
- ⑤ AT-90의 일차 도금은 Ni-B 또는 Ni-P를 실시합니다.
- ⑥ AT-90액은 건조시에는 더미 작업을 통해 활성화 후 본 작업을 실시하여 주십시오.
동일 재료로 0.3dm²/L로 10분간